

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
【部門区分】第 7 部門第 2 区分  
【発行日】平成24年4月5日 (2012.4.5)

【公開番号】特開2010-272622(P2010-272622A)  
【公開日】平成22年12月2日 (2010.12.2)  
【年通号数】公開・登録公報2010-048  
【出願番号】特願2009-121857(P2009-121857)  
【国際特許分類】

H 0 1 L 21/60 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 L 21/60 3 0 1 P

【手続補正書】  
【提出日】平成24年2月17日 (2012.2.17)  
【手続補正 1】  
【補正対象書類名】特許請求の範囲  
【補正対象項目名】全文  
【補正方法】変更  
【補正の内容】  
【特許請求の範囲】  
【請求項 1】

ボンディング領域とプローブ領域とが区分された長形状の複数のボンディングパッドが配置された主面と、前記主面とは反対側の裏面と、を有する四角形の半導体チップを搭載する半導体装置であって、

前記半導体チップは、前記ボンディングパッドの上層に保護膜を有し、

前記保護膜は、前記ボンディングパッドの周縁部を覆い、前記ボンディングパッドの上面が露出するように開口されており、

前記ボンディング領域における前記ボンディングパッドの周縁部と前記保護膜との重なり幅が、前記プローブ領域における前記ボンディングパッドの周縁部と前記保護膜との重なり幅よりも広いことを特徴とする半導体装置。